

ETFE FILM 半導體離型專用

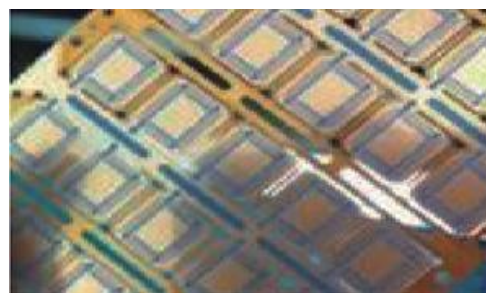
ETFE 薄膜具有優良的耐熱性、光線透過性、電器絕緣性、非粘著性，能適用於半導體封裝過程。

ETFE 薄膜特徵：

- 耐熱性——可在 150°C~180°C 下使用。
- 化學性——耐受外界各種苛刻條件。
- 非粘著性——離型後，產品表面光潔無污染。

適應：

- 半導體封裝解決方案



特性：

比重	融點	透光率	拉伸強度	斷裂伸長率
1.75	260°C	95%	39.5MPa 以上	200%~500%

標準規格：

厚度	寬度	長度	表面狀態
25μ	1360mm	1000m/捲	高透膜、磨砂膜可選， 長度、寬度可根據客戶 指定供應。
50μ	1400mm	500m/捲	

宜進新材料股份有限公司

E-JIN New Material CO., LTD

8 2 4 0 0 9 高 雄 市 燕 巢 區 新 生 南 路 1 0 8 巷 2 8 號

TEL：07-6143301 FAX：07-6143303 Mail：e-jin@ejin.com.tw